

EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION DATE : 04-10-85

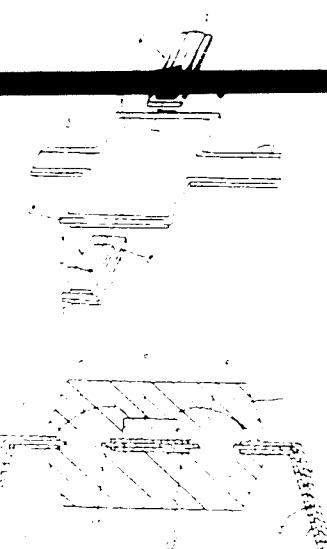
APPLICATION DATE : 19-03-84
APPLICATION NUMBER : 59052093

APPLICANT : HITACHI LTD.

INVENTOR : NAKAZAWA MIROSUJI

INT.CAT. : H01L 23/48, H01L 23/26

TITLE : LEAD FRAME



ABSTRACT : PURPOSE: To improve the contacting property between a lead frame and a resin and to enhance the sealability and the reliability by stepwisely forming the side of the lead frame, and increasing the contacting surface with the resin.

CONSTITUTION: Projections 8, 15 are formed on tabs 4, 13 of a lead frame, tab hanging lead 5 and the sides of leads 6, 14. The projection 8 is formed by a suitable method. The lead frame 12 is, for example, composed of 42-alloy. A semiconductor chip 9 is formed, for example, of silicon single crystal substrate, many circuit elements are formed in the chip by the know technique, and one circuit function is formed. A resin sealer 11 is formed, for example, of epoxy resin, and molded by a known transfer molding method.

COPYRIGHT: (C)1985,JPO&Japic

⑪ 公開特許公報 (A) 昭60-195957

⑫ Int. Cl.

H 01 L 23/48
23/28

識別記号

府内整理番号

7357-5F
7738-5F

⑬ 公開 昭和60年10月4日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

⑭ 発明の名称 リードフレーム

⑮ 特願 昭59-50939

⑯ 出願 昭59(1984)3月19日

⑰ 発明者 谷川喬太 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武藏工場内
 ⑱ 発明者 中沢洋 小平市上水本町1450番地 株式会社日立製作所武藏工場内
 ⑲ 出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地
 ⑳ 代理人 弁理士 高橋明夫 外1名

明細書

発明の名称 リードフレーム

特許請求の範囲

- 側面に突出部を設けて成ることを特徴とするリードフレーム。
- 前記リードフレームがプラスチックモールド用リードフレームである、特許請求の範囲第1項記載のリードフレーム。

発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明はリードフレームに関し、特に、モールドレンジとの密着性を良くし、封止性のよい樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームに関する。

〔背景技術〕

リードフレームの構造の一例としては第1図を示すごときものが周知である(工業調査会刊行)IC

チップの内部配線をコネクタワイヤにより外部に引出するリードである。このリード側の電極及び半導体チップ側の電極をコネクタワイヤを用いて、周知の超音波ポンディング法などによりポンディングして電気的接続を行った後に、樹脂(レンジン)を周知のトランスファー・モールド法などにより半導体チップやポンディング部上にモールドし、リード3を切断成形するなどして樹脂封止型の半導体装置を得ることができる。

ところで、かかる樹脂封止型半導体装置においては、リードフレームとレンジンとの密着性を良好にし、封止性(耐湿性)を向上させ、信頼度を向上させることが必要であり、近時は半導体チップの大形化に伴ない、封止巾が増々狭くなっている。これら事項の重要性も増大している。

従来のこのような樹脂封止型半導体装置が使用されるリードフレームにあっては、その裏面が

本発明はリードフレームとレジンとの密着(接觸)面積を増大させて、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、封止性を向上し、信頼度の高い樹脂封止型半導体装置を得ることができるリードフレームを提供することを目的としたものである。

本発明の前記ならびにそのほかの目的と新規な特徴は、本明細書の記述および取付図面からあきらかになるであろう。

【発明の概要】

本願において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりである。

すなわち、本発明ではリードフレームの側面に段付けを行い、レジンとの接触面を増大させ、リードフレームとレジンとの密着性を良好にし、リードフレーム表面積増大によるリードバスの伸長をはかって外部からの侵入ガス等の浸透性異物の侵入の半導体チップへの到達時間を長にして、封止性

を向上させ、良品率を高めし、信頼性を向上させることを成功した。

【実施例】

次に、本発明を実施例に基づき説明する。

第1図は本発明リードフレームの要部俯視図、第3図は第2図I-I断面図を示す。

これら図において、4は半導体チップを搭載するためのチップ、5はタブ用リード、6はリード、7は樹脂ホールドに必要な奥路穴である。本発明リードフレームにあっては、これら図に示すように、タブ4、タブ用リード5、及びリード6側面に突出部8を設けて成る。この突出部8の形成は、例えば、通常の方法により側面がフラットに形成されたリードフレームの周縁部から適宜幅を上下からプレス機械により押圧して当該側面から突出部が突出するように形成してもよいし、又ニッカッピにより周縁部から適宜幅を上下から適宜の深さでエッチング除去することにより形成してもよく、その仕事量の方法が採用できる。

第4図は本発明リードフレームを使用して成る

樹脂封止型半導体装置の断面図を示し、第4図にて、9は半導体チップ、10はコネクタワイヤ、11は樹脂封止体、12はリードフレームで半導体チップ9を搭載しているタブ13、及び半導体チップ9の内部配線をコネクタワイヤ10を用いて外部に引出するリード14にはそれぞれ突出部15が設けられている。

本発明リードフレームは、例えば42アロイ合金により構成される。半導体チップ9は、例えばシリコン単結晶基板より成り、周知の技術によつて、このチップ内には多數の回路素子が形成され、11の回路機能を与えている。回路素子は例えば絶縁ゲート型電界効果トランジスタ(MOSトランジスタ)から成り、これらの回路素子によって、例えば論理回路およびメモリの回路機能が形成されている。コネクタワイヤ10は、例えばアルミニウム(アルミ)細線により構成される。

樹脂封止体11は、熱可塑性樹脂により成る。

実施例を示し、第2図に示すリードフレームのリード6の上面に、さらに、適宜の間隔で横方向に複数の綫条の導部16を設けて成る実施例を示す。近時、第4図に示すような樹脂封止型半導体装置において、半導体チップ9が大型化し、リード14の樹脂封止体11に埋込まれる長さが次第に短くなってきてている。そうすると、リード14を折曲げて第4図に示すような折曲げリードとする場合、折曲げ時にリードがほつれ、リードがレジンから剥離してしまう、リードが樹脂封止体外端にかけた形にならざることとなる。かかる導部16を設けることにより、より一層、リードフレームとレジンとの密着性を向上し得る。

【効果】

(1) リードフレームの切断面に段付けを行ない、側面に突出部を形成するようにしたので、その分リードフレームとのレジンとの密着面積が増大し、

が形成されているのでリードバスが長くなり、その結果外部からの半導体装置内部への侵入性異物の侵入が遅くなり封止性（耐侵性）が向上する。

(3) リードフレームとレジンとの密着性、封止性の向上により製品寿命を延命し、樹脂封止型半導体装置の信頼性を著しく向上することができる。

(4) 半導体チップが大型化し、リードのモールドレジン中へ埋め込まれている部分が増々短くなっている今日、リードフレームに腹付けを行い、リードフレームとレジンとの密着性の向上の図り、封止性を向上し、半導体装置の信頼性を向上し得ることは工業上極めて有意義である。

(5) リードフレームの側面に突出部を設けることにより、第5図に示すように、リードの上面に溝部を形成することにより、より一層リードフレームとレジンとの密着性が向上させることができ、さらによりリード折曲げ成形に設し、リードがゆるんだり、樹脂封止体の外殻に突出したりすることを防止できる。

以上本発明によつてなされた実施例を実施例によつて具体的に説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなく、その要旨は逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。

例えば、前記実施例では、リードフレーム側面全体に突出部を設けた例を示したが、一部に突出部を設けても差支えない。又前記実施例では露出部をリード上面のみに設けた例を示したが、リードの上下面あるいは下面のみに設けてよい。

〔利用分野〕

本発明はデュアルインライン(DIL)タイプのパッケージの他、フラットパックタイプのパッケージなど他の樹脂封止型半導体装置にも適用することができ、樹脂封止型半導体装置全般に適用できる。又電子部品のパッケージ技術にも適用できる。

図面の簡単な説明

第1図はリードフレームの従来例を示す平面図。

第2図は本発明リードフレームの要部斜視図。

第3図は第2図I-I線断面図。

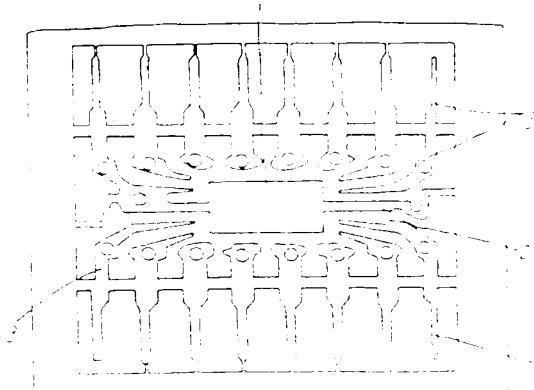
第4図は本発明リードフレームを使用して成る樹脂封止型半導体装置の断面図。

第5図は本発明の他の実施例を示すリードフレームの平面図である。

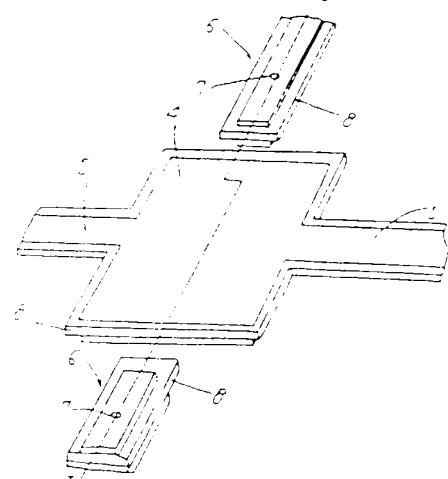
1…タブ、2…タブ吊りリード、3…リード、4…タブ、5…タブ吊りリード、6…リード、7…樹脂穴、8…突出部、9…半導体チップ、10…コネクタワイヤ、11…樹脂封止体、12…リードフレーム、13…タブ、14…リード、15…突出部、16…溝部。

代理人 井藤士 高橋 明天

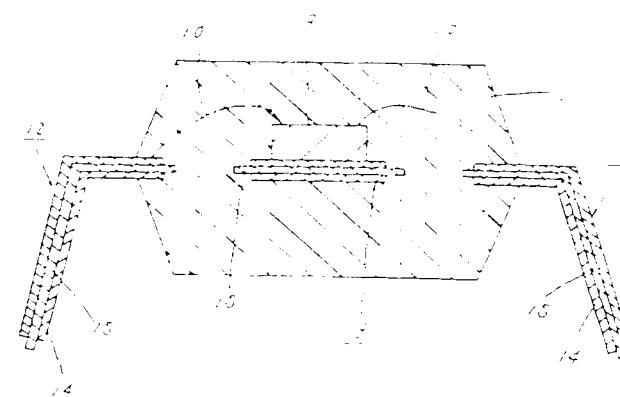
第 1 図



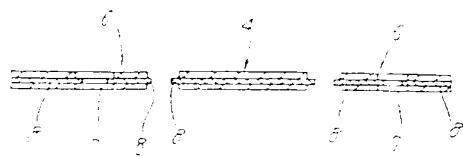
第 2 図



第 4 図



第 3 図



第 5 図

